

中国电工技术学会

电技学字[2026]第 098 号

关于召开半导体集成电路（FPGA） 在航天领域中的应用及电工材料新技术 标准化研讨会的通知

各有关单位：

中国电工技术学会定于 2026 年 8 月 14 日-16 日在海南文昌召开“半导体集成电路（FPGA）在航天领域中的应用及电工材料新技术标准化研讨会”。现将会议有关事项通知如下：

一、组织单位

主办单位：中国电工技术学会

承办单位：中国电工技术学会标准工作委员会电工材料
新技术工作组

二、会议时间及地点

报到时间：2026 年 8 月 14 日

会议时间：2026 年 8 月 15 日-16 日

会议地点：维也纳国际酒店（文昌排球馆店）（海南省
文昌市文昌大道 400 号）

三、会议内容

(一) 主题报告

- 1、半导体集成电路（FPGA）在航天领域中的应用技术探讨
- 2、半导体集成电路现场可编程门阵列功能测试技术标准化探讨
- 3、异构 SoC 与 FPGA 人工智能基础普及交流
- 4、核设施安全级电缆材料技术突破与应用
- 5、接枝改性聚丙烯绝缘电缆发展现状
- 6、智能化纤维在未来科技产业的应用
- 7、电工材料新技术在新能源系统的应用及标准化研讨

(二) 参观交流

四、报名方式及费用

1、报名方式

请参会代表于 8 月 14 日前扫描下方二维码注册报名。



2、会议费用

会议收取注册费 2000 元/人。请参会代表扫码登录会议系统报名注册后，选择相应的方式缴费。如选择银行汇款方式缴费，请汇款时留言备注“标准+参会代表姓名+单位”，

并将汇款凭证上传到会议系统。会议发票将在会后发送至注册邮箱。

汇款账户如下：

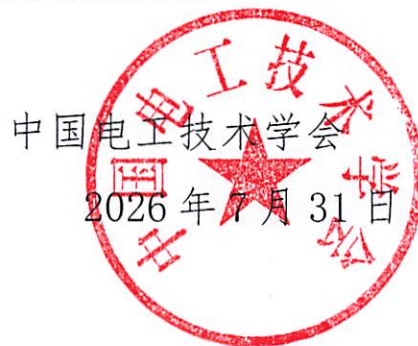
户 名：中国电工技术学会

开户银行：工商银行北京礼士路支行

账 号：0200003609089061350

五、联系方式

王老师 010-63256793，许老师 15821692410





主题词：召开 研讨会 通知

中国电工技术学会

2026 年 7 月 31 印发